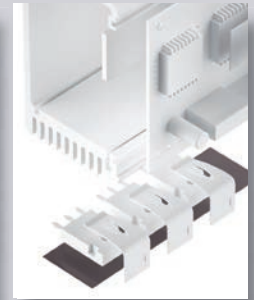


ISOLATIONSFILM TFO-Q-SI-PI

silikonbeschichtet, hohe Durchschlagsfestigkeit



TFO-Q-SI-PI ist eine thermisch leitfähige Folie aus einem elektrisch isolierenden Polyimid Trägerfilm mit wärmeleitenden Silikonbeschichtungen auf beiden Seiten zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kühlflächen. Durch die spezielle Formulierung und Füllung des Silikons mit Keramikfüllstoffen ergibt sich eine hohe Leitfähigkeit. Unter Druck stellt sich ein sehr geringer thermischer Gesamtwiderstand ein. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit auf. Der Trägerfilm sorgt für höchste mechanische Stabilität und eine einfache Handhabung.



Stand 11 / 2018

EIGENSCHAFTEN

- Sehr guter thermischer Kontakt
- Sehr hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit
- Hohe mechanische Stabilität durch Trägerfilm
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Rückstandslose Entfernung nach Anwendung

LIEFERFORMEN

- Matte 320 x 400 mm
- Andere auf Anfrage
- Rolle 320 mm x 50 m
- Nicht haftend (TFO-Q150-SI-PI)
- Als lose Formstanzeile

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

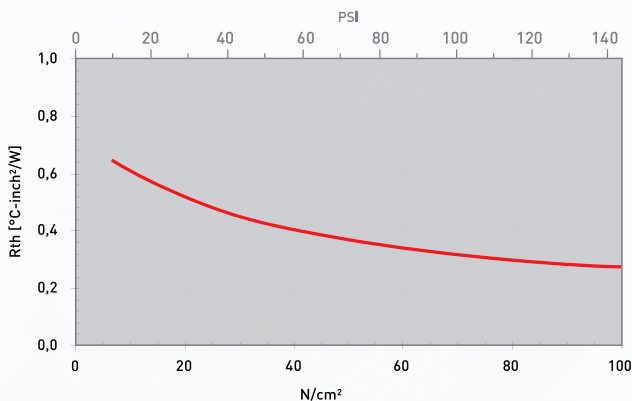
- MOSFETs und IGBTs
- Dioden und Gleichrichter
- Elektronische Module z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgungen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen / Automotiv Anwendungen / Solartechnik

Eigenschaft	Einheit	TFO-Q150-SI-PI
Material		Mit Keramik gefüllter silikonbeschichteter Isolationsfilm
Farbe		Dunkelgrau
Verstärkung		Polyimid Isolationsfilm
Dicke	mm	0,15
Entflammbarkeit	UL 94	V0
RoHS Konformität	2011 / 65 / EU	Ja
Thermisch		
Widerstand ¹ @ 1 MPa	°C-inch ² /W	0,28
Widerstand ¹ @ 200 kPa	°C-inch ² /W	0,50
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 180
Elektrisch		
Durchschlagsspannung ²	kV AC	> 6

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ ASTM D 5470, ² ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.

Standarddicke: 0,15 mm

Rth vs. N/cm² (PSI)



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktanwendung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.